

## RJ45C6 R1V 3.2N4N TY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A termékválaszték a következő kiviteli változatokat tartalmazza:

- 90°, fekvő (vízszintes) és 180°, álló (függőleges)
- felfelé reteszelő / lefelé reteszelő
- THT, THR vagy SMD forrasztási eljárások
- Különböző kiviteli változatok széles választéka, beépített LED-ekkel és az árnyékolás érintkező füleivel
- Teljesítménykategória Cat. 3 - Cat. 6
- Tálcán (TY) vagy tekercsen (feltekercselt szalag, RL)
- Kompatibilis a moduláris RJ45 csatlakozóval, az ANSI / TIA-1096-A és IEC 60603 szabványnak megfelelően.
- Átütési szilárdság  $\geq 1500$  V AC RMS (2250 V AC csúcsérték) az IEEE 802.3 szerint
- Átütési szilárdság  $\geq 1500$  V AC (csúcsérték) vagy  $\geq 1500$  V DC az IEC 60603 szerint

Tulajdonságok és előnyök:

- Bővített,  $-40$  °C és  $+85$  °C közti hőmérséklet-tartomány a maximális teljesítmény érdekében
- Megerősített aranyréteg ( $30 \mu\text{m}$ ) a megnövelt korrózió elleni védelem érdekében
- A legalább 0,3mm-es kiemelkedés tökéletes forrasztást eredményez.

## Általános rendelési adatok

Verzió	NYÁK dugaszoló csatlakozó, RJ45 jacks, Cat. 6 , THT/THR-forrasztott csatlakozással, 180°, LED: Nem, Pólusszám: 8, Tray (manual assembly)
Rendelési szám	<a href="#">2634590000</a>
Típus	RJ45C6 R1V 3.2N4N TY
GTIN (EAN)	4050118651270
Qty.	140 Stück
Csomagolás	Tray (manual assembly)

## RJ45C6 R1V 3.2N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	16,7 mm	Mélység (coll)	0,657 inch
Magasság	16,5 mm	Magasság (coll)	0,65 inch
Szélesség	16 mm	Szélesség (coll)	0,63 inch
Nettó tömeg	7,475 g		

## Electrical properties

Névleges feszültség	125 V	PoE / PoE+	IEEE 802.3at szerint
Szigetelés erőssége	≥ 500 MΩ	Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	1500 V DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	1000 V DC		

## Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	PA 9T	Szín	fekete
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Szigetelés erőssége	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C

## Csomagolás

Csomagolás	Tray (manual assembly)	VPE hosszúság	317 mm
VPE szélesség	188 mm	VPE magasság	68 mm

## Rendszerspecifikációk

Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás	Dugaszolási ciklusok	750
Felszerelés NYÁK-ra	THT/THR-forrasztott csatlakozással	Forrasztási eljárás	Reflow forrasztás, Kézi forrasztás, Hullámforrasztás
Forrasztótüske hossza (l)	3,2 mm	Forrasztótüske méretei	Nyolcszögletű
Kategória	Cat. 6	Kimenő könyök	180°
LED	Nem	Osztás, inch (P)	0,05 "
Osztás, mm (P)	1,27 mm	Pólusszám	8
Teljesítménykategória		Termékcsalád	OMNIMATE Data - RJ45 moduláris csatlakozó
Tolerance of solder pin position	± 0.1 mm	Védelmi osztály	IP20
Árnyékolás	Igen	Árnyékolás felülete	nikkelezett

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9,1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

**RJ45C6 R1V 3.2N4N TY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[Certificate of Compliance](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

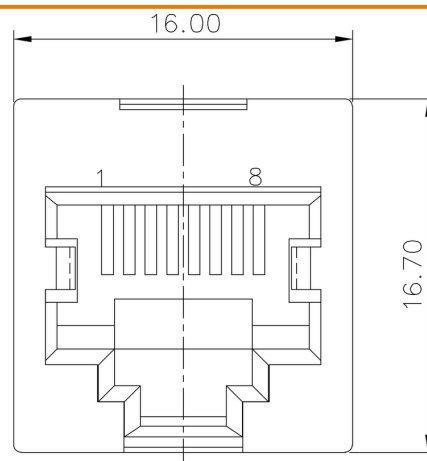
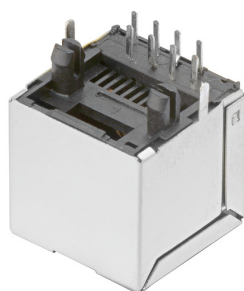
## RJ45C6 R1V 3.2N4N TY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

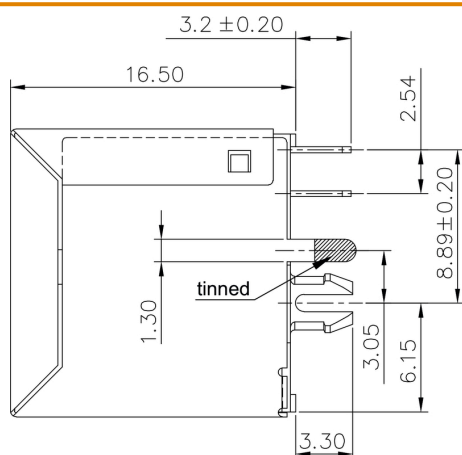
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

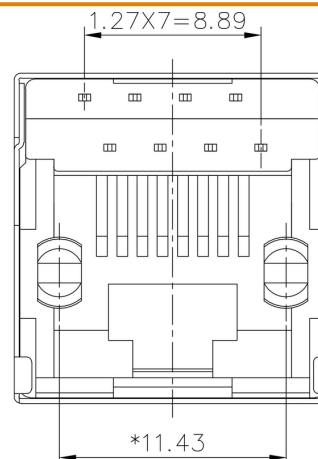
### Méretrajz



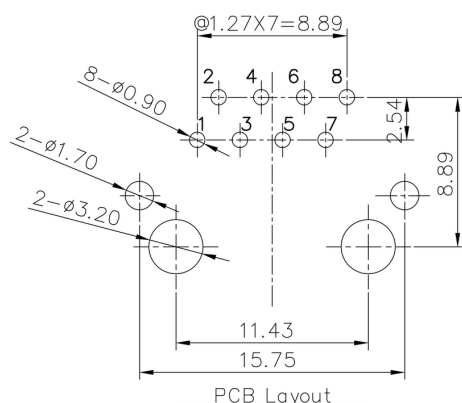
### Méretrajz



### Méretrajz



### NYÁK kivitel



RJ45C6 R1V 3.2N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
  
www.weidmueller.com

Rajzok

RJ45	G1	R	1	U	3.2	E	4	GY/GY	TY	RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY
										Packaging
										TY
										RL
										Tray in box (manual assembly) Tape on Reel (automated assembly)
										LED
										Y/G
										Green/Yellow (standard)
										GY/GY
										Green/Yellow/Green-Yellow
										O/G
										Orange/Green
										R/O
										Red/Orange
										...
										(further combinations possible)
										N
										without LED
										Contact surface thickness
										4
										1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"
										EMI tabs (ground fingers)
										E
										E = with EMI tabs
										N
										N = without EMI tabs
										Solder Pin length
										3.2
										3.2 mm
										1.6
										1.6 mm
										D
										SMD
										Direction, latch style
										U
										Horizontal (90°, side entry), latch up
										D
										Horizontal (90°, side entry), latch down
										V
										Vertical (180°, top entry)
										Y
										Diagonal (45°), latch up
										Number of Ports
										1
										1 Port
										12; 14; ...
										multi ports side by side, Multiport
										21; 41; ...
										multi ports about each other, Multilevel
										Assembly on PCB
										R
										Through Hole Reflow - THR
										Soldering process: Wave or Reflow soldering
										S
										Surface Mount Technology - SMT
										Soldering process: Reflow soldering
										T
										Through Hole Technology - THT
										Soldering process: Wave
										Performance Category
										C5
										Category 5
										C6
										Category 6
										C6A
										Category 6A
										C5e
										Category 5e
										M
										10/100 Mbit
										G1
										10/100/1000 Mbit
										G10
										10 Gbit
										U
										Unshielded
										MP
										10/100 Mbit with POE
										MP+
										10/100 Mbit with POE+

Jelmagyarázat

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 9:51:43 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## Recommended wave soldering profiles

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Single Wave:



### Double Wave:



### Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

## Recommended reflow soldering profile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



## Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3\text{K/s}$ . In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq -6\text{K/s}$  solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.